

陕西源杰半导体科技股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”专项行动方案

的半年度评估报告

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的理念，维护公司全体股东的利益，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据2026年度“提质增效重回报”行动方案，积极开展和落实各项工作，现将2026年上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦经营主业，提升经营质量

公司聚焦于半导体激光器芯片行业，主营业务为半导体激光器芯片的研发、设计、生产与销售，目前公司的主要产品为半导体激光器芯片，主要应用于电信市场、数据中心市场等领域。其中电信市场可以分为光纤接入、移动通信网络。在光通信领域中，公司主要产品包括2.5G、10G、25G、50G、100G、200G以及更高速率的DFB、EML激光器系列产品和50mW、70mW、100mW等大功率硅光光源产品，主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域。

经过多年研发与产业化积累，公司已建立了包含芯片设计、晶圆制造、芯片加工和测试的IDM全流程业务体系，拥有多条覆盖MOCVD外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等全流程自主可控的生产线。

通过持续的研发投入构建差异化竞争优势，公司从电信市场收入为主的半导体激光器芯片供应商，逐步发展成为国内领先的“电信市场+数通市场”协同拓展的半导体激光器芯片供应商。公司将继续深耕半导体激光器芯片行业，致力成为国际一流光电半导体芯片和技术服务供应商。

2026年上半年，公司实现营业收入92,515.05万元，同比增加351.40%；实现归属于上市公司股东的净利润60,707.29万元，同比增加1,212.20%。公司的电信市场业务实现收入14,843.70万元，较上年同期增加48.63%。公司的数据中心业务实现收入77,421.66万元，较上年同期上升640.29%。

1、持续加大研发投入，提升核心竞争力

2026年上半年，公司持续保持较高研发投入水平，研发支出4,257.90万元，占营业收入比例为4.6%。公司围绕高速率、大功率、高可靠性方向开展系统性技术升级，强化研发成果向产业化转化的效率，提升核心技术竞争力。

电信市场领域，对原有的2.5G、10G的DFB、EML产品持续加强生产过程管控，借以提升产品的良率和稳定性。随着无线和10G PON光纤接入部署逐步进入成熟期，行业需求增长放缓。公司在此背景下，积极配合海内外设备商提前布局下一代25G/50G PON所需DFB/EML产品，此应用需根据不同的上下行要求对应不同芯片规格，公司具备和客户一同推进方案开发的先发优势，在良好的产品匹配度下，已实现批量发货。目前50G PON已由标准制定走向商用部署，国内运营商陆续启动相关设备集采，产业链国产化程度持续提升，为把握未来电信市场增长机遇奠定了坚实的基础。

数据中心领域，随着人工智能的快速发展，光模块正加速向高速率演进，800G光模块已进入规模部署，1.6T光模块自2026年起进入规模商用阶段。报告期内，公司的CW 70mW、100mW激光器产品持续大批量交付，并进一步优化工艺水平。该产品采用非制冷设计，具备高功率输出和低功耗特性，适用于数据中心高速场景。公司的高速EML产品，在100G PAM4 EML产品已经批量出货的基础上，更高速率的200G PAM4 EML产品客户验证工作稳步推进。

与此同时，CPO/NPO等新型封装技术通过高度集成实现了更高的带宽密度和更低的功耗，被视为1.6T及以上速率的解决方案之一。此类新型的封装方式，对激光器芯片提出了更高的要求，公司瞄准这一机遇，基于目前在CW激光器芯片市场的行业和技术积累，研发了多款CW激光器芯片，如120mW/300mW/400mW等多款产品，目前正结合客户需求推进产品验证与研发，相关产品的参数及指标会根据下游市场需求进一步迭代。

2、加强人才队伍建设，优化人才激励机制

公司紧抓行业发展机遇，持续扩大业务规模，人力资源通过多元化招聘渠道加速引进专业人才，扩充人才队伍，员工人数实现较快增长，有效支撑了公司业务拓展与战略落地。同时，公司高度重视专业人才培养，不断优化培养机制，在扩大人才队伍的基础上，结合经营安排和实际需求，持续优化人员结构，为员工提供优质

发展平台，合理配置各岗位人员数量。通过阶梯式培养，公司核心团队成员持续稳定增长，促进效能提升，为公司高质量发展提供坚实的人才保障。

3、推进募投项目建设，提升生产制造水平

2026年，在全球算力设施建设进程加速的背景下，数据中心需求持续升级，进而带动全球光模块及半导体激光器芯片市场规模的快速扩大。为紧抓市场机遇，更好满足客户对多样化产品的需求，公司进一步加大投资力度，积极推进扩产布局。在投资规模和资金安排方面，经董事会和股东会审议通过，公司于2026年3月对“50G光芯片产业化建设项目”的投资规模再次调整，总投资由4.87亿元调增至7.57亿元，目前该项目正在稳步推进中。同时，经股东会审议通过，公司于2026年3月启动“光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目”的建设工作，该项目计划总投资约12.51亿元。截至目前，二期项目正在稳步推进中。

4、加强重点客户拓展，推进海外市场布局

2026年上半年，公司持续把握半导体激光器市场的发展契机，密切关注市场需求的发展动态，持续加强市场开拓力度，积极拓展下游客户，稳固并提升公司的行业地位。在数据中心市场快速发展的背景下，公司持续投入资源加强销售体系建设，提升整体营销水平，在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化的服务和解决方案。

同时，为持续推进公司国际化战略及全球化布局，搭建国际化资本运作平台，增强境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，公司于2026年3月6日、2026年3月23日分别召开第二届董事会第二十七次会议、2026年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案。H股上市完成后，公司将依托全球化资本平台，进一步夯实资本实力，提升综合竞争力，为全球市场拓展注入新动能。

二、优化产品结构，提高经营和风险管理水平

公司根据市场需求，积极推动产品线从传统电信市场逐步向数据中心领域产品转型。2026年，公司在持续深耕电信市场的基础上，积极把握AI发展带来的数据中心市场机遇。2026年半年度，公司数据中心业务实现收入7.74亿元，较上年同期上

升640.29%。从产品结构来看，数据中心领域销售额实现大幅度增长，成为公司重要的收入来源。

运营管理方面，面对市场需求大幅增长和产品结构变化，公司积极调整生产安排，运营效率也大幅提升。2026年半年度，公司的年化存货周转率为2.12，相对于2025年半年度同比提高25.10%。

应收账款管理方面，随着公司业务规模的提高，公司仍高度重视应收账款的管理。公司应收账款周转率和应收账款结构也持续优化和改善，2026年半年度，应收账款年化周转率为4.57，相对于2025年半年度同比提高57.92%。

研发投入方面，公司紧密围绕年初的经营策略，持续加大大功率CW、EML等高功率和高速率芯片的研发投入。2026年上半年，研发费用为4,257.90万元，同比增长59.28%。在持续的研发投入下，公司的产品结构进一步优化，数据中心在主营业务的占比逐步提高。

三、完善公司治理，实现高质量发展

公司严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合自身实际情况，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系建设，规范运作流程，提升决策水平，具体内容如下：

1、关注政策变化，完善公司治理制度

2026年上半年，公司在全面贯彻落实最新法律法规要求的基础上，持续跟进境内外法律法规及监管政策动向。为满足公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，公司结合香港联合交易所的监管要求，于2026年3月6日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后适用的公司章程（草案）及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订及制定相关内部治理制度（草案）的议案》，相关制度将自公司发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效并施行。

同时，公司也通过组织参加各类培训，及时传递监管最新政策动态及要求，持续加强董事及高级管理人员的履职能力建设，充分发挥“关键少数”在公司治理中的重要作用，促进公司规范运作水平不断提升。

2、完善内控体系建设，保障公司稳健运营

2026年上半年，公司在2025年内控审计工作基础上，坚持以《内部审计制度》为统领、各专项管理制度为支撑，依托信息化系统实现全流程业务追溯，开展2025年度公司全业务流内控工作评价及日常自查整改工作，并据此持续优化业务流程、健全内控体系，推动相关管理制度及配套业务手册的修订完善。

2026年上半年，公司严格对照年度计划方案，稳步推进内控体系优化、常态化审计监督、问题闭环整改等各项工作，内控管理规范性进一步提升。针对现存问题点，公司将通过制度条款的增补与修订持续优化完善，全力确保年度内控建设各项任务顺利完成，为公司高质量、可持续发展提供坚实内控保障。

3、重视“关键少数”，推动可持续发展

2026年上半年，公司共召开股东会会议3次，董事会会议5次、独立董事专门会议2次、审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议2次、战略委员会会议3次。公司通过高效有序的会议机制，充分发挥“关键少数”在公司治理中的关键作用，持续提升规范运作水平和科学决策能力，切实保障全体股东的合法权益。

同时，公司积极组织董事、高级管理人员参加各类培训，及时传递监管政策动态，不断提升履职能力，强化合规意识，推动公司治理水平持续优化。

四、提升信披水平，加强投资者沟通

公司始终秉承“以投资者为中心”的理念，致力于与投资者建立和谐、畅通、合规、高效的沟通机制，加强公司与投资者之间的理解与信任。

1、提升信披水平，加强投资者沟通

2026年上半年，公司共召开了2次业绩说明会，分别参与由上海证券交易所举办的“上海证券交易所主办的十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度数字芯片设计行业集体业绩说明会”，以及在陕西证监局指导下陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”。公司管理层通过网络在线交流形式，积极回应市场关注，就投资者所关注的公司经营问题进行沟通。

同时，公司于2026年上半年通过价值在线平台线上召开了“2025年年报业绩交流会”，董事长、总经理及公司管理层等领导亲自出席，就公司的经营成果、财务状况等信息进行详细解读，并对投资者提出的问题都给予充分的回答，从而持续增

强投资者对公司的信心，提升信息披露透明度。

2、提高信披透明度，增强投资者信心

2026年上半年，公司在定期报告披露后，以一图读懂等形式直观呈现经营成果，帮助投资者更便捷地了解公司情况。与此同时，公司充分拓展利用上交所“e互动”平台、投资者邮箱、投资者热线、投资者交流会及股东会等方式，为投资者提供便捷的沟通途径，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，树立市场信心。

五、以投资者为本，提高投资者回报

公司坚持以投资者为本的原则，建立“长期、稳定、持续”的股东价值回报机制，不断增强投资者信心，建立长期的信任。

2026年4月20日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增4.5股，不送红股。共计派发现金红利59,970,789.90元（含税），本次转增股本后，公司的总股本为124,500,377股。2026年5月，公司2025年年度权益分派实施完成。

同时，公司为增强广大投资者的获得感，提高投资者回报力度，根据相关法律法规，并结合公司实际情况，拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下进行中期现金分红。并已经股东会授权公司董事会，在综合考虑公司战略发展规划、实际经营情况和发展目标、未来盈利能力、现金流情况、股东回报等因素，合理制定中期分红方案并实施。

下半年，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，不断提升公司核心竞争力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2026年8月27日